

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 27 年 4 月 2 日 (2015.4.2)

【公開番号】特開 2014-187381 (P2014-187381A)
 【公開日】平成 26 年 10 月 2 日 (2014.10.2)
 【年通号数】公開・登録公報 2014-054
 【出願番号】特願 2014-114052 (P2014-114052)
 【国際特許分類】

H 0 1 G 4/232 (2006.01)

H 0 1 G 4/30 (2006.01)

H 0 1 G 2/06 (2006.01)

【F I】

H 0 1 G 4/12 3 5 2

H 0 1 G 4/30 3 0 1 B

H 0 1 G 1/035 C

【手続補正書】

【提出日】平成 27 年 2 月 17 日 (2015.2.17)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

複数の誘電体層が積層されてなる直方体状の積層体であって、積層方向の両端に位置する上面及び底面、互いに対向する第 1 の端面及び第 2 の端面、並びに、互いに対向している第 1 の側面及び第 2 の側面を有している積層体と、

前記誘電体層と共に積層され、かつ、該誘電体層を介して互いに対向している第 1 のコンデンサ導体及び第 2 のコンデンサ導体と、

前記第 1 の端面及び前記第 1 の側面のそれぞれに設けられ、かつ、前記第 1 のコンデンサ導体と接続されている第 1 の外部電極及び第 2 の外部電極と、

前記第 2 の端面及び前記第 2 の側面のそれぞれに設けられ、かつ、前記第 2 のコンデンサ導体と接続されている第 3 の外部電極及び第 4 の外部電極と、

を備えており、

前記第 1 の端面と前記第 2 の端面との間の距離は、前記第 1 の側面と前記第 2 の側面との距離よりも長く、

前記第 1 の端面及び前記第 1 の側面において、前記第 1 の外部電極と前記第 2 の外部電極との間には、該第 1 の外部電極及び該第 2 の外部電極と異なる電位に保たれる外部電極が設けられておらず、

前記第 2 の端面及び前記第 2 の側面において、前記第 3 の外部電極と前記第 4 の外部電極との間には、該第 3 の外部電極及び該第 4 の外部電極と異なる電位に保たれる外部電極が設けられておらず、

回路基板の実装の際に、鳴きの抑制のために、前記第 1 の外部電極又は前記第 2 の外部電極のいずれか一方を該回路基板のランド電極に接続し、かつ、前記第 3 の外部電極又は前記第 4 の外部電極のいずれか一方を該回路基板のランド電極に接続すること、

を特徴とする電子部品。

【請求項 2】

請求項 1 に記載の電子部品と、

基板本体、及び、該基板本体の主面上に設けられ、かつ、前記第１の外部電極ないし前記第４の外部電極に対応する第１のランド電極ないし第４のランド電極を、有する回路基板と、

を備えており、

前記第１の外部電極と前記第１のランド電極とが接続され、

前記第３の外部電極と前記第３のランド電極とが接続され、

前記第２の外部電極と前記第２のランド電極とが接続されず、

前記第４の外部電極と前記第４のランド電極とが接続されないこと、

を特徴とする実装構造体。

【請求項３】

請求項１に記載の電子部品と、

基板本体、及び、該基板本体の主面上に設けられ、かつ、前記第１の外部電極ないし前記第４の外部電極に対応する第１のランド電極ないし第４のランド電極を、有する回路基板と、

を備えており、

前記第２の外部電極と前記第２のランド電極とが接続され、

前記第４の外部電極と前記第４のランド電極とが接続され、

前記第１の外部電極と前記第１のランド電極とが接続されず、

前記第３の外部電極と前記第３のランド電極とが接続されないこと、

を特徴とする実装構造体。

【請求項４】

前記基板本体は、該基板本体の主面の法線方向から平面視したときに、長方形状をなし
ており、

前記第１のランド電極と前記第３のランド電極とは、前記基板本体の主面の法線方向から平面視したときに、該基板本体の長辺が延在する方向に並んでおり、

前記第２のランド電極と前記第４のランド電極とは、前記基板本体の主面の法線方向から平面視したときに、該基板本体の短辺が延在する方向に並んでいること、

を特徴とする請求項２又は請求項３のいずれかに記載の実装構造体。

【請求項５】

前記第１のランド電極ないし前記第４のランド電極は、前記基板本体の主面の法線方向から平面視したときに、該基板本体の主面の中央に設けられていること、

を特徴とする請求項４に記載の実装構造体。

【手続補正２】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】０００７

【補正方法】変更

【補正の内容】

【０００７】

本発明の一形態に係る電子部品は、複数の誘電体層が積層されてなる直方体状の積層体であって、積層方向の両端に位置する上面及び底面、互いに対向する第１の端面及び第２の端面、並びに、互いに対向している第１の側面及び第２の側面を有している積層体と、前記誘電体層と共に積層され、かつ、該誘電体層を介して互いに対向している第１のコンデンサ導体及び第２のコンデンサ導体と、前記第１の端面及び前記第１の側面のそれぞれに設けられ、かつ、前記第１のコンデンサ導体と接続されている第１の外部電極及び第２の外部電極と、前記第２の端面及び前記第２の側面のそれぞれに設けられ、かつ、前記第２のコンデンサ導体と接続されている第３の外部電極及び第４の外部電極と、を備えており、前記第１の端面と前記第２の端面との間の距離は、前記第１の側面と前記第２の側面との距離よりも長く、前記第１の端面及び前記第１の側面において、前記第１の外部電極と前記第２の外部電極との間には、該第１の外部電極及び該第２の外部電極と異なる電位に保たれる外部電極が設けられておらず、前記第２の端面及び前記第２の側面において、

前記第 3 の外部電極と前記第 4 の外部電極との間には、該第 3 の外部電極及び該第 4 の外部電極と異なる電位に保たれる外部電極が設けられておらず、回路基板の実装の際に、鳴きの抑制のために、前記第 1 の外部電極又は前記第 2 の外部電極のいずれか一方を該回路基板のランド電極に接続し、かつ、前記第 3 の外部電極又は前記第 4 の外部電極のいずれか一方を該回路基板のランド電極に接続すること、を特徴とする。